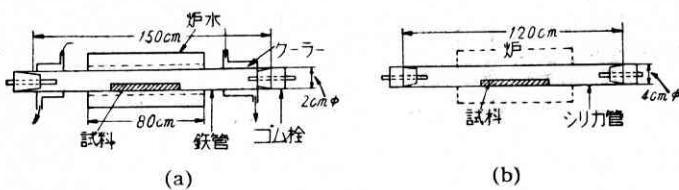


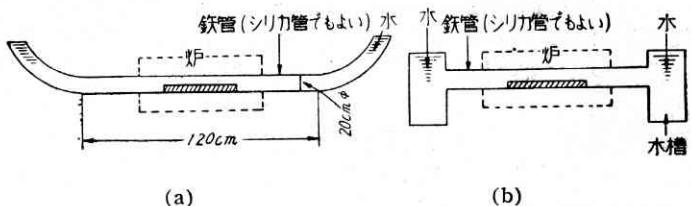
實験ノート

金属の光輝焼鈍法

金属の再結晶、調質などの熱処理は高温で行わなければならないが、一方金属は高温では酸化しやすい。そこで金属を酸化させずに焼鈍する方法、すなわち光輝焼鈍法がいろいろ工夫されている。真空や不活性ガス、水蒸気などを用いる方法があるが、筆者たちが実験室で試み



第1圖 真空焼鈍装置



第2圖 水蒸氣焼鈍装置

た鐵と銅の光輝焼鈍法を二三紹介する。

(1) 真空焼鈍：細長い試料を焼鈍するため、第1圖aに示すような鐵管をニクロム爐に装入して使用した。試料を入れた鐵管の両端にガラス管を貫通したゴム栓を付け、ビセインで密封し、ガラス管をセンコ型真空ポンプ ($30\text{ l}/\text{min}$) に導く。鐵管は熱の傳導性がよく、加熱するとゴム栓部のビセインが軟化するので、図のようなクーラーを付ける必要がある。シリカ管を用いるとクーラーはいらない。試料が鐵の時はガイスター管で螢光ができる程度の真空 (10^{-2} cm) で酸化は起きない。銅なら 10^{-1} cm で 1000°C まで加熱してもよい。第1圖bにはシリカ管を用いた例を示した。この位の寸法の管では $50\text{ l}/\text{min}$ の真空ポンプを使えばまい。シリカ管にはクーラーは不用で徐冷に適するが、こわれやすい。鐵管は冷却速度が早く、破損しにくい利點がある。

(2) 水蒸氣焼鈍：第2圖aのような鐵管を爐に入れ管の中へ試料と一緒に水を充満しておく。爐温を次第に上げて行くと水は次第に膨脹して両端から溢れ出るが、加熱部分が 100°C 以上になると試料の周りは水蒸氣の氣體だけになり、温度が上るにつれて水蒸氣分子の密度が減つて試料と氣體分子の接觸の頻度が少くなるので、真空焼鈍と同様に酸化を起さない光輝焼鈍を行うことができる。筆者は銅の焼鈍にこの方法を利用して成功を収めた。第2圖bのように両端を水槽にすると、その寸法を適當にすることによって試料を移動することもでき（これは真空焼鈍では困難）、工夫すれば長い線材の連續焼鈍も可能である。

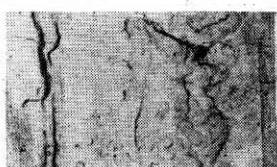
(1951.5.29. 加藤正夫、武谷清昭)

速報 25 ラッピング機構について

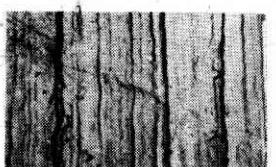
松永正久

ラッピング試験機を試作して、ラッピングの際の表面の変化を日本光学製上面検査機、福島式 NF 粗度計、電子顕微鏡および電子廻折装置等を用いて研究した。使用した材料は炭素工具鋼第四種および第六種、ブロックゲージ用鋼 ($C=0.45\sim0.55$, $Cr=0.5\sim1.0$, $W=0.5\sim1.0$) 及 18-8 不鏽鋼で、ラップには鑄鐵、ラッピングパウダーには WA #320 を用い、乾式ラップを行った。ラッピング前の仕上は研磨により、凹凸は 0.8μ である。

研磨方向に直角にラッピングする場合の試料の表面を電子顕微鏡で観察すると、初期 (200 行程ラッピング) における表面は直角方向に平行な凹凸の複数の帯状構造である。



第1圖



第2圖

一方、行程 72 軸、ラッピング圧力 400 gr/cm^2 においては第1圖のように下地の研磨きずが見られるが、さらにラッピングが進むと (400 行程) 表面の小突起が押しつぶされて、熔融に似た様相を呈する (第2圖)。さらにラッピングが進行するとはじめて平坦な面 (第3圖) になる。この際の電子廻折写真は後二者とも何れもハローであり、結晶構造は認められない。チップは初期においてはラッピングパウダーが破碎した相當大きな塊 ($2\sim5\mu$) を見るが、次第に微細となり、終期においては球状の小さなチップ (1μ 以下) を生ずる。

研磨目と同方向にチップするときは、この現象は直角方向の場合程顯著ではない。触針による粗さは中期以後はほとんど平坦で區別は困難であるが、NF 粗度計によるときは NF 粗度には變化なく、平坦度を増加するだけである。

以上の結果について詳細は目下検討中であり、さら

にラップ面の変化、ラッピングパウダーの形態と切削能、面の粗さと反射能、ラッピング面の電子廻折による研究等について実験を續行中で、これらの結果は近く発表する豫定である。



第3圖